



우타르프라데시 반도체 정책 2024

우타르프라데시주 정부 IT 및 전자부

DISTINATION UTTAR PRADESH

Invest in BIDA



내용물

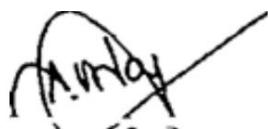
전문.....	.삼
정책 의 비전과 목표	4
비전	4
2.2 정책의 목적.....	4
거버넌스	4
3.1 노드 에이전시.....	4
3.2 정책 구현 단위(PIU).....	5
3.3 권한 있는 위원회(EC).....	5
정책 시행 범위	5
정 4.1 보험 기간 및 적용 범 위.....	5
4.2 자격 기준.....	5
4.3 이용 약관	6
5. 승인 및 지출	7
5.1 승인 프로세스.....	7
5.2 보조금 지급	7
6. 인센티브	7
6. 1 재정적 인센티브	7
6. 2 비재정적 인센티브.....	9
7. 신청 절차	11
8. 용어 설 명.....	12
9. 약어.....	16

1 전문

반도체 제조는 산업 전반에 걸쳐 현대적인 발전을 이루는 데 중추적인 역할을 합니다. 스마트폰, 컴퓨터, 의료 장비와 같은 장치의 효율성을 향상시킵니다. 또한 AI, IoT, 양자 컴퓨팅 분야의 혁신도 촉진합니다. 경제적으로는 복잡한 공급망을 통해 일자리 창출과 성장을 촉진하는 한편, 투자는 기술 주권과 글로벌 경쟁력을 보장합니다. 디지털 시대, 반도체는 혁신을 주도합니다. 연결성, 번영.

인도 반도체 미션은 인도를 글로벌 반도체 플레이어로 만드는 것을 목표로 합니다. 현지 생산, R&D에 초점을 맞추고 수입 의존도를 줄이는 임무는 혁신과 고급 일자리 기회를 육성합니다. 인프라를 개선하고, 협업을 활성화하고, 숙련된 인력을 양성함으로써 이 이니셔티브는 인도의 기술 자율성과 반도체 및 전자 분야의 글로벌 입지를 향상시킵니다. 이는 디지털 우수성과 글로벌 반도체 환경에 대한 실질적인 기여에 대한 인도의 열망과 일치합니다.

인도 정부의 비전에 맞춰 국가 GDP의 약 9%를 차지하는 빠르게 성장하는 경제인 우타르프라데시주 내 반도체 생태계 육성에 전념하고 있습니다. 이러한 노력은 전자 제조 및 혁신의 확장을 가속화할 준비가 되어 있습니다. 이는 1조 달러(USD) 경제가 되겠다는 국가의 야망과 조화를 이루며, 따라서 인도를 5조 달러(USD) 경제로 발전시키려는 Hon'ble 총리의 중요한 목표와도 일치합니다.



정책의 비전과 목표

2.1 비전

숙련된 인력의 효과적인 사용, 혁신 및 신기술 적용을 통해 우타르프라데시의 중요한 성장 동력으로 반도체 제조를 육성하기 위한 세계적으로 경쟁력 있는 인프라와 우호적인 정책 환경을 제공함으로써 우타르프라데시를 반도체 산업의 선호 목적지로 만드는 것. 생태계를 조성하여 국가와 국가 경제 전반의 성장에 기여합니다.

2.2 정책의 목적

우타르프라데시 반도체 제조 정책의 주요 목표는 다음과 같습니다.

- 전략적으로 중요한 영역에서 인도의 경제 성장을 촉진하고, 혁신을 촉진하고, 실질적인 고용 기회를 창출하고, 인도의 자립심을 강화할 준비가 되어 있는 우타르 프라데시에서 강력한 반도체 제조 생태계를 구축합니다.
- 고급 설계 및 테스트 도구를 갖춘 최첨단 인프라를 개발하여 스타트업 간의 협업을 촉진합니다. 기업 및 교육 기관이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다.
- 주 내에서 지원적인 팝리스 생태계 육성에 중점을 두고 있습니다.
칩 설계 기업 및 스타트업을 대상으로 합니다.
- 업계 와 학계 간의 강력한 연결을 구축하여
커리큘럼 개선, 전자 교육에 대한 정기적인 업데이트, 주의 기술 개발 임무를 통한 전공 기술 구축 워크숍 촉진을 통해 숙련된 인재 풀을 육성합니다.
- 중장기적으로 잠재적인 제조 시설 설립에 도움이 되는 환경을 조성하는 동시에 반도체 설계 및 제조 공정에서 더 높은 부가가치를 강조합니다.

3. 거버넌스

3.1 노드 에이전시

UP Electronics Corporation Limited는 부서 산하 Nodal Agency입니다.

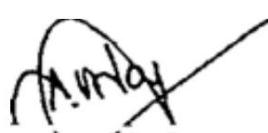
IT&전자과, 정부 우타르프라데시주가 다음을 담당할 것입니다.

우타르프라데시 반도체 정책 2024의 효과적인 시행.

해당 기관은 주 내 반도체 생태계의 지속적인 성장을 위해 유리한 정책 환경을 조성하는 일을 담당합니다.
이 밀

모든 생태계 이해관계자의 참여를 위한 단일 창구 역할을 합니다. Single Window 운영을 관리하기 위해 Nodal Agency는 전담 조직을 설립할 것입니다.

정부를 지원하기 위해 아웃소싱 전문가와 컨설턴트로 구성된 프로젝트 관리 부서(PMU).



3.2 정책실행부(PIU)

PIU는 수석 비서/추가 비서실장을 위원장으로 합니다. 호다에이전시 (Hoda\ Agency)의 업무를 감독하기 위해 IT전자부를 둔다 . PIU는 권한위원회에 권고사항을 제시하는 것을 포함하여 정책의 효과적인 구현을 담당합니다. PIU는 필요한 승인을 위해 권한위원회에 투자 제안을 검토하고 추천할 책임이 있습니다.

이 위원회는 ACS/PS가 산업 개발부, 주세무부, 인지 및 등록부, IT 및 전자 부문에서 지명한 구성원으로 구성됩니다. 재무, 주택부, 노동부 및 요구 사항에 따라 필요한 경우 다른 부서/산업 개발 기관 등의 구성원이 포함될 수 있습니다.

3.3 권한 있는 위원회 {EC}

정책의 효과적인 이행을 모니터링하기 위해 사무총장이 의장을 맡은 주정부 권한 위원회가 설치되어야 합니다. 위원회 현장은 모든 수준에서 투자자 문제를 적시에 해결하는 것과 관련하여 정책의 효과적인 구현 및 부서 간 조정과 관련되어야 합니다. 정책에 따라 적용되는 모든 프로젝트는 권한 부여 위원회의 재추천에 대해 내각의 승인을 받아야 합니다.

이 위원회는 산업개발부, 국세청, IT 및 전자, 금융, 기획, 중소기업의 ACS/PS로 구성됩니다. 상업세, 에너지, 관개, 주택 부서, 노동 및 요구 사항에 따라 필요한 경우 추가 최고 비서/다른 부서의 주요 비서/산업 개발 기관의 CEO 등이 포함될 수 있습니다.

정책에 따라 구성된 권한 있는 위원회는 정책의 연장/수정을 결정해야 합니다.

4. 정책 시행 및 적용 범위

4.1 보험 기간 및 적용 범위

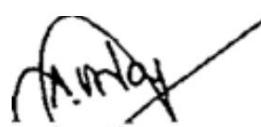
UP-반도체 정책 2024는 통지일로부터 5년 동안 유효합니다.

이 정책은 주 전체에 적용됩니다. 정책 고시일부터 투자가 허용됩니다.

계획의 혜택을 받는 기관은 전체 프로젝트의 상업적 생산 시작일로부터 최소 3년 동안 상업적 생산 운영을 유지하기로 약속해야 하며, 그러한 취지의 공식 약속을 제공해야 합니다.

4.2 자격 기준

인도 정부의 ISM(India Semiconductor Mission)의 다음 계획 중 하나에 따라 자격을 갖춘 프로젝트는
이 정책에 따라 자격을 갖습니다.



4.1.1 인도의 반도체 공장 설립 계획

4.1.2 인도 디스플레이 공장 설립 계획

4.1.3 인도의 화합물 반도체/실리콘 포토닉스 센서 제조 시설 및 반도체 조립, 테스트, 마킹 및 패키징(ATMP)/OSAT 시설 설정 계획.

4.1.4 다음에 의해 수정되거나 제안되는 기타 유사한 계획

인도 정부.

4.1.5 Design Linked Incentives에 따라 승인되거나 Fab-less 활동과 관련된 프로젝트는 이 정책에 따라 자격이 없지만 투자자는 UP IT/ LTES 정책 2022에 따라 혜택을 신청하고 이용할 수 있습니다.

4.2 적격 투자

4.2.1 반도체 공장: 프로젝트 비용의 백분율로 FiSCdl 지원은 인도 정부 Meity가 인도 내 반도체 공장 설립을 위한 수정된 계획에 대해 발행 한 지침의 섹션 2. 12에 정의된 활동으로 제한됩니다. 2023년 5월 29일, 수시로 수정됩니다. (용어집 8(ii))

4.2.2 디스플레이 공장: 프로젝트 비용의 백분율로 나타낸 재정 지원은 2023년 5월 29일 인도 정부 Meity에서 발표한 인도 디스플레이 공장 설립을 위한 수정 계획 지침의 섹션 2.12에 따라 정의된 활동으로 제한됩니다. 수시로 수정됩니다. (용어집 6(ii))

4.2.3 ATMP/OSAT: 자본 지출 대비 재정 지원은 제한되어야 합니다.

2023년 6월 30일 인도 정부 Meity가 인도 내 ATMP/OSAT 시설 설립을 위한 수정 계획 지침(수시 개정) 섹션 2.1 1에 따라 정의한 활동에 적용됩니다. (용어집 8(iii))

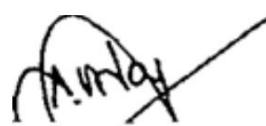
이용약관

이 정책은 주의 다른 정책/제도와 꼭 들어맞을 수 없습니다. 그러나 인도 정부의 계획/정책에 따라 긴밀한 협력이 허용됩니다. 본 정책에 명시된 모든 인센티브는 인도 정부의 모든 제도/정책에 따라 제공되는 인센티브에 추가로 제공될 수 있습니다. 정부가 제공하는 인센티브/보조금에는 인도 정부가 승인한 총 적격 프로젝트 비용의 100'1에 해당하는 전체 상한선이 적용됩니다.

다양한 반도체 관련 시설을 구축하기 위한 수정 계획에 따라 제안된 프로젝트의 사업 비용에 이미 자본 지출 또는 투자가 포함되어 있습니다. 반도체 탑을 포함합니다. 디스플레이 패, 화합물 반도체/실리콘 포토닉 센서 패, 반도체 조립, 테스트, 말링 및 패키징(ATMP). OSAT 시설 및 유사한 정부 계획은 알림 CG-DL-E-04 102022-239339 da(ed 04.

2022년 10월, CG-DL-E-06102022-239340

2022년 10월 4일자 및 2023년 6월 9일자 CG-DL-E-1006Z023-246449는 자본 보조금만 받을 수 있으며 정책에 설명된 다른 혜택은 받을 수 없습니다.



4. 승인 및 지급

4.1 승인 프로세스:

반도체 작업장, 디스플레이 제조, 화합물 반도체를 포괄하는 이니셔티브에 대한 제안서가 제출되었습니다. 실리콘 포토닉스(SiPh), 센서(MEMS 포함) Fab. 인도의 Discrete Semiconductors Fab 및 Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility는 인도 ISM (India Semiconductor Mission) 정부의 승인을 받아 현재 진행 중입니다. Uttar Pradesh 주 내에서 추진된 사건은 Hon'ble State Cabinet 승인을 위해 보내질 것입니다. Hon'ble State Cabinet의 승인은 권한 부여된 위원회가 제공한 권장 사항에 따라 수행됩니다.

- GoUP 승인 프로세스: 인도 정부의 인도 반도체 임무(India Semiconductor Mission)에서 승인한 제안입니다. 반도체 시설 설립을 모색하고 있습니다 (Uttar Pradesh의 4.2.1, 4.2.8 및 4.2.3j에 정의된 대로 승인된 인센티브가 전체 적격 프로젝트의 100%를 초과하지 않는다는 조건에 따라 LOC가 제공 됩니다). ISM이 승인한 비용과 발행된 LoC는 인도 정부가 제안을 승인한 후에만 유효합니다 .

- 신청자는 UP-Semiconductor Policy 2024에 따라 동시에 신청해야 합니다.
India Semiconductor Mission에 제안서를 제출하는 동안

4.2 보조금 지급

인도 정부가 제공하는 인센티브에 추가로 제공되는 자본 인센티브입니다. 인도 정부가 투자자에게 지분을 공개한 후에만 지급되며 지급은 Pari Passu 모드에서 이루어집니다.

기타 모든 재정적 인센티브. 자본 보조금 외에도 토지 비용에 대한 리베이트, 인지세 및 정책에 명시된 등록 수수료 면제는 상업 생산 시작 시 적용됩니다.

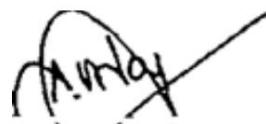
6가지 인센티브

이 정책에 따라 제공되는 재정적 인센티브는 인도 정부가 제공하는 인센티브보다 높습니다 . 그러나 정책에 달리 명시되지 않는 한 인도 정부가 제공하는 인센티브를 포함하여 모든 출처에서 단위가 청구하는 인센티브입니다 . 적격 프로젝트 비용의 100년을 초과할 수 없습니다(본 정책의 4.3항에 정의됨) .

6.1 재정적 인센티브

6.1.1 자본 보조금: GOI가 승인한 자본 보조금의 50년. 이 혜택은 Pari-Passu 모드에서 인도 정부가 제공하는 혜택에 따라 지급됩니다.

6.1.2 이자 보조: 정기 은행/금융 기관에서 얻은 대출에 대해 최대 INR 200 Cr을 투자한 단위에 대해 연간 5%(이자율) 의 이자 보조금은 최대 INR 1 Cr까지 상환됩니다. 7년 동안 단위당 연간 (단위당 최대 INR 7 Cr)



D. 보조금은 프로젝트 승인 시 50%, 승인 후 3년 후 25%, 5년 내 약속된 결과 달성 시 25%씩 분할 지급됩니다.

6.1.1 우수 센터(CoE):

정책은 반도체 부문의 연구와 혁신을 촉진하기 위해 CoE(Center of Excellence) 형태로 세계적 수준의 인프라를 구축하는 것을 구상하고 있습니다. 정책은 평판이 좋은 학술 기관 및/또는 업계 협회/업계 또는 기타 정부/민간 단체와 협력하여 Center of Excellences를 설립하는 것을 목표로 합니다. 총 CoE 프로젝트 비용의 최대 505(최대 10 Cr.)는 UP 정부가 부담합니다.

회사는 6.1.9항 또는 6.1.10항 중 R&D 센터 또는 Centre of Excellence 설립에 대한 보조금을 받을 수 있는 옵션 하나만 고려해야 합니다.

6.1.2 특허 등록비 상환:

특허 등록 티셔츠는 국내 특허 취득에 대해 최대 Rs 10 lakh, 한 번에 국제 특허 취득에 대해 최대 Rs 20 lakh에 해당하는 비용의 759 비율로 (1회) 상환됩니다.

6.1.3 산업용 주택:

단위 부지 반경 10km 이내의 근로자 주택/기숙사 및 관련 집단 시설 개발 비용의 10% 또는 INR 10 crore 중 더 낮은 금액이 연간 7회 균등 분할 지급됩니다.

6.2 비재정적 인센티브

6.2.1 미션 크리티컬 인프라: 주의 반도체 산업은 필수 서비스 및 유지 관리법(ESMA)에 따라 필수 서비스 제공자로 분류됩니다.

6.2.2 물 공급: 주정부 프로젝트 현장의 반도체 장치에 물 공급을 보장합니다.

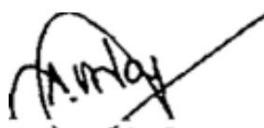
6.2.3 장치는 개방형 접근을 통해 전원을 공급받을 수 있어야 합니다.

6.2.4 재생 가능/녹색 에너지를 위한 파워 뱅킹이 해당 장치에 제공되어야 하며, 해당 주의 전기 규제 위원회 ERC 지침에 따라 관리됩니다.

6.2.5

6.2.6 정부는 FAB 프로젝트의 원활한 운영을 위해 안정적인 전력 공급을 보장하기 위해 전력망의 충분한 이중화를 보장합니다.

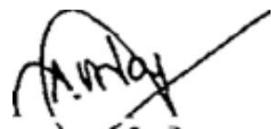
6.2.6 비방해 조항: 보장된 비즈니스 연속성을 제공하기 위해. 개발자가 투자를 완료하고 해당 당국으로부터 완료 증명서를 받고 임대 임대료를 모두 지불한 후 해당 당국의 반도체 단위가 위반할 경우 임대 계약을 취소하려면 Board of Authority의 승인이 전제 조건이 됩니다. 규범/조례.



6.2.7 3교대 운영: 반도체 사업부는 여성 직원의 안전 및 보안과 관련하여 필요한 예방 조치를 취하는 경우 24시간 연중무휴 운영 및 3교대 근무에 여성 고용이 허용되어야 합니다.

6.2.8 자체 인증: 반도체 장치는 특정 불만 사항으로 인해 발생하는 검사를 제외하고 다음 법령 및 규칙에 따라 검사가 면제됩니다. 이러한 단위에서는 규정된 형식으로 자체 인증서를 제출할 수 있습니다.

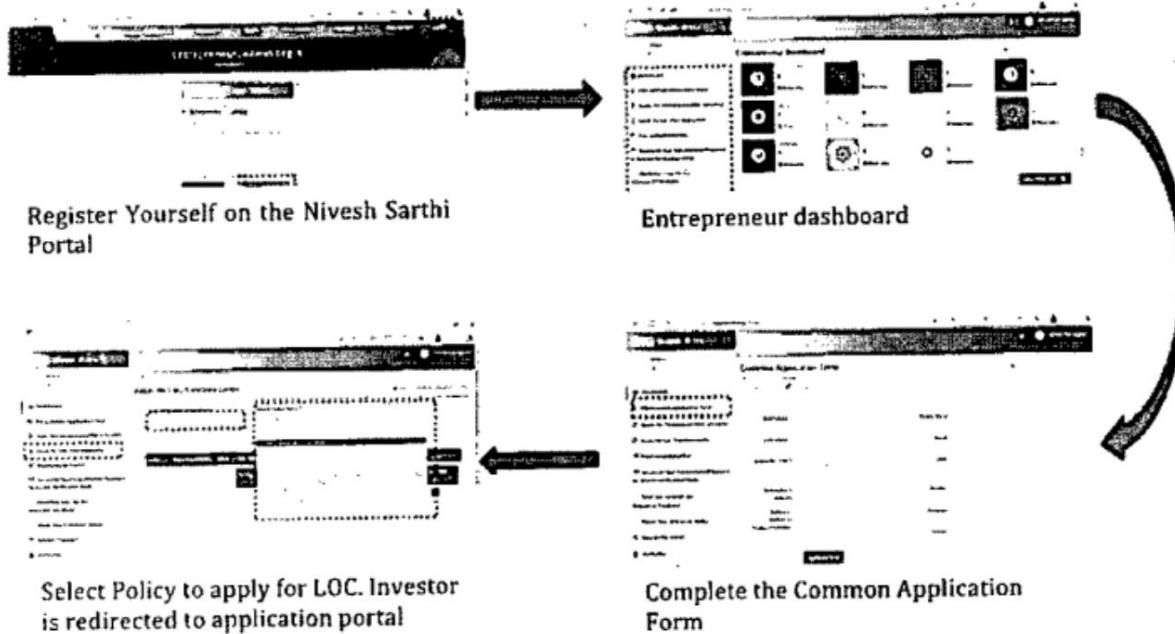
- 공장법 • 출산 혜택법 • 상점 및 시설법
- 계약노동(규제 및 폐지)법 • 임금지급법 • 최저임금법

A handwritten signature in black ink, appearing to read "한국인", is placed here.

7. 신청절차

Uttar Pradesh의 단일 창 포털(<https://niveshmifra.up.nic.in/>)인 Nivesh Mitra는 비즈니스 프로세스를 단순화하는 온라인 플랫폼입니다. 온라인 신청, 문서 업로드, 수수료 지불, 실시간 상태 추적 및 디지털 서명된 NOC가 가능합니다. 우타르프라데시 주에서 사업을 시작하고 운영하는 데 필요한 사전 설립, 사전 운영, 간접 및 추가 인증서를 위한 필수 허가, 라이센스, LOC 및 NOC 발급을 처리합니다.

신청자는 Nivesh Mitra 포털을 사용하여 제안서를 제출해야 하며, 제안서를 제출하면 온라인 인센티브 관리 시스템으로 안내됩니다. 여기서 그들은 UP-반도체 정책 2024에 따라 IT 및 전자 부서로부터 LOC(편의서)를 신청하기 위해 프로젝트와 관련된 필수 제안 세부 사항 및 문서를 제출해야 합니다.



8. 용어집

반도체 제조: 다양한 전자 제품에 사용되는 반도체 장치를 만드는 과정입니다.

나. 반도체 및 디스플레이 공장 설립을 위한 적격 자본 투자: 반도체 공장 설립을 위한 수정 계획 지침(고지 번호 CG-DL-E-06102022-239339) 및 수정 계획 설정 지침의 섹션 2.12에 설명된 대로 디스플레이 Fab(고시 번호 CG-DL-E-O61O2022-239340I 파일 번호

2022년 5월 29일자 W-38/21/2022/PHW

프로젝트 비용에는 자본 지출/투자가 포함됩니다.

- 토지, 건물, 공장, 기계, 클린룸, 장비. 및 관련 유틸리티
- 연구개발 기술이전
- 건설 중 DS이자 및 기타 관련 비용
 보험 비용

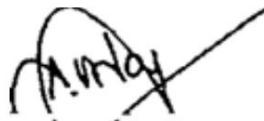
iii. 화합물 반도체/실리콘 포토닉스/센서 패드/디스크리트 반도체 패드 및 반도체 ATMP 및 OSAT 설정을 위한 적격 자본 투자: 화합물 반도체/실리콘 포토닉스/센서 페이드/디스크 설정을 위한 수정 계획 지침의 섹션 2.1 1에 설명된 대로 인도의 반도체 제조 시설 및 반도체 조립, 테스트, 마킹 및 패키징(ATMP)/아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 시설(이하 '계획')이 영상 공고 번호 CG-OL-E-06102022-로 공고되었습니다.

2022년 10월 4일자 239341(개정된 비디오에 따름) 통지 번호 CG-DL-E-100620Z-

2023년 6월 9일자 246449, 파일 번호 W-38/2 1/2022/IPHW

2023년 6월 30일

- 건물, 플랜트, 기계에 발생한 자본 지출/투자Y. 깨끗한
- 객실, 장비 및 관련 유틸리티
- 연구 및 연구에 발생하는 자본 지출/투자
 개발((R&D))
- 기술이전 관련 자본지출/투자
 (ToT) 계약



- 프로젝트/단위에 필요한 토지에 발생한 지출은 계획에 따른 적격 자본 지출/투자 계산에 고려되지 않습니다.

인도 반도체 임무(ISM): 인도 반도체 임무 iv.

(ISM)은 Digital India Corporation, 전자 정보 기술부(MeitY), 인도 정부 내에서 반도체 및 디스플레이 제조 생태계 개발을 위한 프로그램/수정 프로그램 구현을 위한 주요 기관입니다.

인애. Nodal Agency: 감독을 담당하는 주요 정부 기관입니다.

우타르프라데시주에서 반도체 정책을 시행합니다.

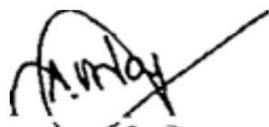
vi. 정책실행부(PIU): 수석 비서/추가 비서실장이 의장을 맡은 전문 부서입니다. Nodal Agency의 업무를 감독하는 IT 전자 부서입니다.

vii. 권한위원회(EC): 사무총장이 의장을 맡은 각급 위원회로, 정책 이행 모니터링 및 부서 간 조정을 담당합니다.

viii. 인도의 반도체 공장에 대한 수정된 계획은 전자정보기술부(Meit YN)로부터 2022년 10월 4일 관보 통지 번호 CG-DL-E-04102022-239339를 통해 통지되었습니다.

수정된 계획은 인도에 반도체 공장을 설립하기 위한 프로젝트 비용의 SOA 재정 지원을 제공합니다. 프로젝트 비용에는 토지, 건물, 공장, 기계, 장비 및 관련 유틸리티 비용이 포함됩니다. 재정 지원은 계획 지침 및 승인 서신에 명시된 조건에 따라 신청서 승인 후 패리파스(pari-passu) 방식으로 제공됩니다.

ix. 인도의 디스플레이 공장에 대한 수정된 계획은 2022년 10월 4일 전자정보기술부(tMeit Y)로부터 공보 통지 번호 CG-DL-E-04102022-239340를 통해 통지되었습니다. 수정된 계획은 인도에 디스플레이 공장을 설립하는 데 필요한 프로젝트 비용 중 50g을 재정적으로 지원합니다. 프로젝트 비용에는 토지, 건물, 공장, 기계, 장비 및 관련 비용이 포함됩니다.



유용. 재정 지원은 계획 지침 및 승인 서신에 명시된 조건에 따라 신청서 승인 후 패리파스(pari-passu) 방식으로 제공됩니다.

엑스. 인도의 인도 소재 복합 반도체 및 ATMP 시설에 대한 수정된 계획은 2022년 10월 4일 전자정 보기술부(MeitY)로부터 공보 통지 번호 CG DL-E-06102022-239341을 통해 통지되었습니다. 인도의 화합물 반도체 및 ATMP 시설에 대한 수정된 계획은 화합물 반도체/실리콘 포토닉스/센서 공장/이산형 반도체 공장 및 반도체 조립, 테스트, 마킹 및 패키징(ATMPJ/아웃소싱 반도체) 설정을 위한 50년대 자본 지출의 재정 지원을 제공했습니다. 인도의 조립 및 테스트(OSAT) 시설.

화합물 반도체(Compound Semiconductors): 주기율표의 서로 다른 족에 속한 두 개 이상의 원소로 구성된 반도체 재료.

디스플레이 제조(Display Fabrication): 전자산업에 사용되는 디스플레이를 제조하는 과정

장치.

팹리스 생태계(Fabless Ecosystem): 자체 제조 시설 없이 반도체 칩 설계 및 개발에 중점을 둔 생태계입니다.

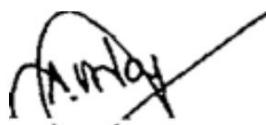
Letter of Comfort tLoC]: 발행인이 의무를 이행할 것이라는 확신을 당사자에게 제공하는 데 사용되는 금융 수단입니다.

xv. Pari Passu: Nodal Agency의 비례 지급금은 신청자/프로젝트 회사가 다른 회사와 함께 동원 할 해당 몫 이후에 공개됩니다.

xvi. 비방해 조항: 정책 위반으로 인한 임대 취소에 대해 이사회 승인을 요구하여 비즈니스 연속성을 보장하는 조항입니다.

xvii. OSAT(아웃소싱 반도체 조립 및 테스트) 시설: 반도체 패키징 및 테스트 서비스를 제공하는 시설입니다.

xviii. 반도체 제조(FAB): 반도체 장치를 만드는 과정입니다. 반도체 제조라고도 합니다.

A handwritten signature in black ink is written over a red checkmark. The signature appears to be in cursive script, likely the name of the signatory.

xix. 반도체 포토닉스(Semiconductor Photonics): 정보 처리 및 전송을 위한 광자 빛 입자 사용과 관련된 반도체 기술 분야입니다.

더블 엑스. 경제특구(SEZ): 투자 유치 및 수출 촉진을 위해 사업 및 무역법이 다른 국가와 다르게 지정된 지역입니다.

xxi 자본 보조금: 반도체 제조 프로젝트로 인해 발생하는 자본 비용을 줄이기 위해 정부가 제공하는 재정 지원입니다.

xxii 인지세: 법적 문서, 특히 토지 구매 또는 임대와 관련된 문서에 부과되는 세금입니다.

xxiii. 전력 보조금: 반도체 제조 장치의 전기 비용을 줄이는 재정적 인센티브입니다.

xxiv. 전기세: 전기 소비에 대한 세금입니다.

xxv. 이중 전력망 네트워크: 반도체 제조공장에 중단 없는 전력을 보장하기 위한 중복 전원 공급 장치 인프라입니다.

xxvi. 송전 및 운송 비용: 전기 송전 및 배전과 관련된 비용입니다.

xxvii. 필수 서비스 및 유지 관리법 fESMA7: 특정 사항을 지정하는 법률

산업이나 서비스를 필수로 간주하여 중단 없는 운영을 보장합니다.

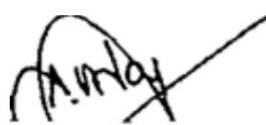
XXViii. 개방형 액세스(Open Access): 단위가 전력망이나 다른 공급업체로부터 직접 전기를 구매할 수 있는 기능입니다.

xxix. 파워뱅킹(Power Banking): 잉여 재생 에너지를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 능력입니다.

트리플 엑스. 사례별 기준: 특정 상황에 따라 개별적으로 결정이 내려집니다.

xxx. 자체 인증: 단위가 외부 검사 없이 특정 노동법 준수를 선언할 수 있는 프로세스입니다.

xxxii. 은행/금융 기관: 모든 지정 은행이 고려됩니다. 인도중앙은행이 규제하고 승인한 모든 금융 기관이 고려됩니다.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. M. J.", is positioned at the bottom right of the page.

9. 약어

- AI - 인공지능
- ATMP - 조립, 테스트, 마킹 및 Packaqinq
- EC - 권한을 위임받은 위원회
- EMC - 전자제품 제조 클러스터
- ESDM - 전자 시스템 설계 8 제조
- FCI - 고정 자본 투자
- GOI - 인도 정부
- IoT - 사물인터넷
- IT - 정보 기술
- ISM - 인도 반도체 임무
- MeitY - 전자정보기술부
- OSAT - 아웃소싱 조립 g 테스트
- PIU - 프로젝트 구현 단위
- PMU - 프로젝트 관리 부서
- 경제특구(SEZ) - 경제특구

면책 조항 이 '우타'

'르프라데시 반도체 정책 2024' 문서는 힌디어가 아닌 사용자의 편의를 도모하고 더 넓은 범위를 제공하기 위해 힌디어 원본을 번역했습니다. 번역의 정확성을 보장하기 위해 최대한 의 주의를 기울였지만 여기에 제공된 조항의 해석에 차이가 있는 경우 '원본' 공보 힌디어 버전이 우선합니다.

